

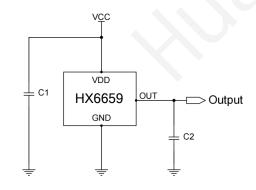
1 产品特点

- 比例式线性霍尔效应磁传感器
- 宽工作电压范围: 2.8V~6.0V
- 低功耗 3.3mA@5.0V VDD
- 低噪声输出
- Vcc/2 静态输出,可检测N极和S极磁场
- 多灵敏度可选
 - A: 1.5mV/Gs, ±1600Gs 范围
 - -B: 2.0mV/Gs, ±1200Gs 范围
 - C: 2.5mV/Gs, ±960Gs 范围
 - D: 3.0mV/Gs, ±800Gs 范围
- 高品质封装: SOT-23 TO-92S
- 工作温度范围: -40℃~125℃
- 卓越的ESD性能: HBM 4KV
- 符合RoHS & REACH 标准

2 典型应用

- 电流传感器
- 电机控制
- 位置检测
- 接近开关
- 高度找平、倾斜和重量测量
- 角度编码

3 应用电路原理图



注: C1:1nF/10V C2:10nF/10V

4 概述

HX6659系列是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁通量密度。HX6659内部电路包含霍尔传感器、线性放大器和CMOS输出级电路。具有高速、低噪声输出特性,在-40℃至125℃的宽温度范围内实现线性性能。可用于消费类工业类各种磁场检测。HX6659具有宽工作电压范围,当不存在磁场时,模拟输出 1/2 Vcc。输出会随施加的磁通量密度呈线性变化,四个灵敏度选项可根据所需的检测范围提供最大的输出电压摆幅。南北磁极产生唯一的电压。HX6659可检测垂直于封装项部的磁通量。由于采用标准的SOT-23贴片和TO-92S插件封装,HX6659可提供不同的检测方向。



SOT-23

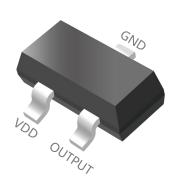


TO-92S



5 引脚定义和标记信息





引脚结构 (俯视图)

引脚名称	引脚序号	功能描述
VDD	1	供电输入端
OUTPUT	2	输出端
GND	3	接地端

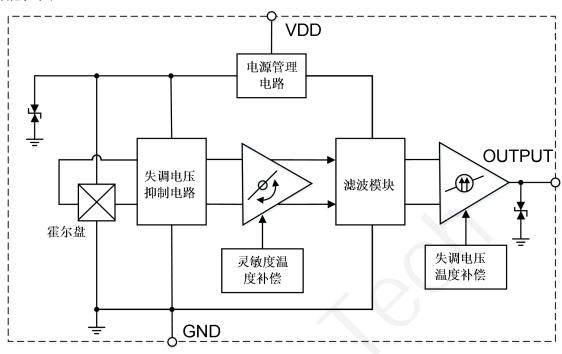
TO-92S



引脚结构 (俯视图)

引脚名称	引脚序号	功能描述
VDD	1	供电输入端
GND	2	接地端
OUTPUT	3	输出端

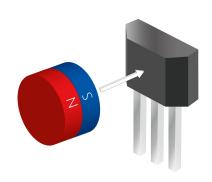
6 功能框图



7 输出特性 (TA=-40℃~125℃, V_{DD}=2.8V~6.0V)

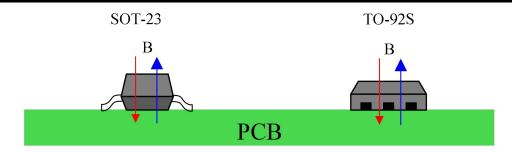
项目	工作条件	输出(TO-92S)	输出(SOT-23)
South pole	B>0 Gauss	>V _{NULL}	>V _{NULL}
North pole	B<0 Gauss	<v<sub>NULL</v<sub>	<v<sub>NULL</v<sub>

如下图,HX6659可检测垂直于封装顶部的磁通量。当磁铁南极靠近芯片顶部时,磁感线由芯片底部向顶部穿过,认为此时磁感应强度B为正;当磁铁北极靠近芯片顶部时,磁感线由芯片顶部向底部穿过,认为此时磁感应强度B为负。

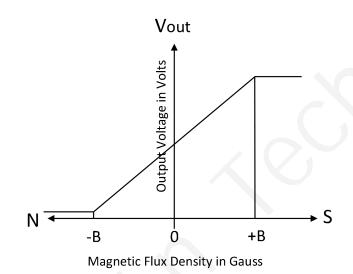




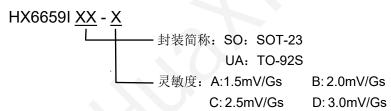




输出特性



8 产品型号构成



9 绝对最大额定值 (@TA=+25℃, 除特别说明外)

项目	参数说明		数值	单位
V_{DD}	供电电压		8	V
$V_{\text{DD_REV}}$	反向电源电压		-0.5	V
I _{OUTPUT}	输出驱动电流		20	mA
V _{OUTPUT}	输出电压		8	V
T _A	工作温度范围		-40∼+125	°C
T _{STG}	存储温度范围		-65∼+150	°C
TJ	结点最高耐温		+150	°C
P _D	封装功耗	SOT-23/TO-92	230/606	mW
ESD HBM	人体模型ESD能力		4000	V

注: 超过绝对最大额定值可能造成永久性损坏。长时间工作于绝对最大额定条件下会影响芯片的可靠性。



10 电参数 (@TA=+25℃, V_{DD}=5.0V 除特别说明外)

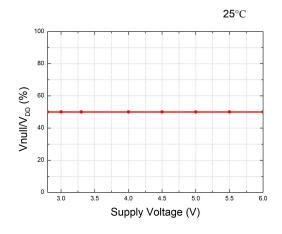
HX6659系列							
项目	参数说明	工作	条件	最小值.	典型值	最大值	单位
V _{DD}	供电电压	工作状态		2.8	_	6.0	V
IDD	功耗电流	工作状态	, B=0 Gs	_	3.3	5.0	mA
Io	输出电流	A, V _{DI}	_D >4V	1.0	1.5	_	mA
lo	输出电流	B/C/D, \	/ _{DD} >3V	1.0	1.5	_	mA
V _{NULL}	0 磁场输出电压	B=0) Gs	2.375	2.5	2.625	V
V _{OH}	输出高电平	B> Max Ma	ngnetic Gauss		4.9	4.99	V
VoL	输出低电平	B> Min Ma	gnetic Gauss	0.01	0.1	_	V
Vos	输出电压摆幅范围	工作	状态	(2)	4.8	_	V
			Α		_	30	mV
Von	输出噪声	Ta=25℃, C _{out} =10nF	В	_		40	mV
		Out 10111	C/D	_	_	50	mV
T _P	上电时间	工作	状态	_	_	150	uS
T _{SW}	输出转换时间	工作	状态	_	—	150	uS
F _{sw}	输出转换频率	工作状态		3	_		kHz
		Д	\	-1600		1600	Gs
Magnetic	7.4.1.7.4.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Е	3	-1200	_	1200	Gs
Range	磁场检测范围	C	;	-960		960	Gs
		D		-800	_	800	Gs
		Д	1	1.38	1.5	1.62	mV/Gs
0	ョ <i>は</i> . 広	В		1.84	2.0	2.16	mV/Gs
Sensitivity	灵敏度	С		2.3	2.5	2.7	mV/Gs
		D		2.76	3.0	3.24	mV/Gs
R _{VON}	0 磁场输出电压误差	实际工作电压/5V 工作电压		_	±1.5	_	%
R _{SEN}	灵敏度误差	实际工作电压/5V 工作电压		_	±1.5	_	%
LIN	线性度	全输出电压范围		_	±1.5	_	%
TC _{Sens}	灵敏度温度系数	Sens@125℃/Sens@25℃		_	±0.1	_	%/℃
δ V _{on}	0 磁场输出电压随温度变化幅度	Von@125℃-Von@25℃		_	20	_	mV

5

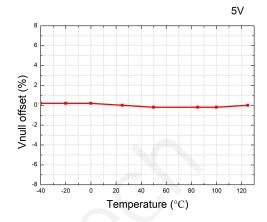


11 性能曲线图

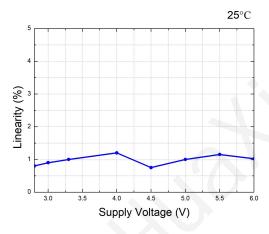
HX6659A/B/C/D



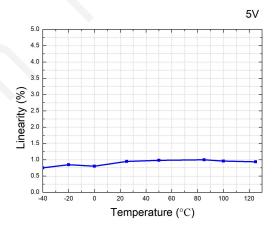
Typical Supply Voltage (V_{DD}) **VS** Ratio of V_{NULL} to V_{DD}



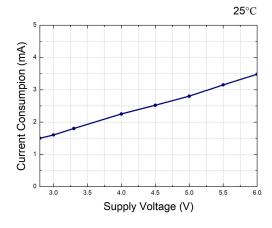
Typical Temperature (TA) VS V_{NULL} Offset



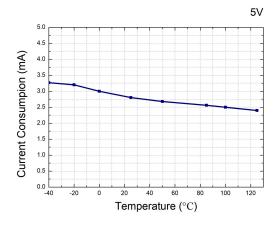
Typical Supply Voltage (VDD) VS Linearity



Typical Temperature (TA) VS Linearity

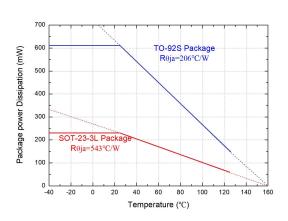


Typical Supply Voltage (VDD) VS Supply Current (IDD)

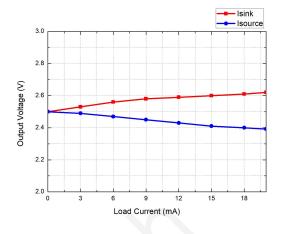


Typical Temperature (TA) VS Supply Current (IDD)

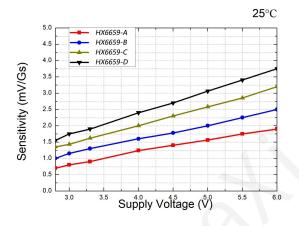




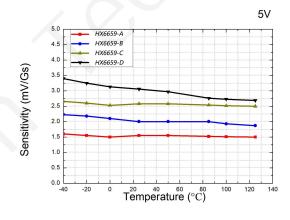
Power Dissipation VS Temperature(TA)



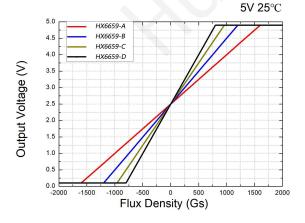
Load Current VS Output Voltage



Typical Supply Voltage(VDD) VS Sensitivity



Typical Temperature (TA) VS Sensitivity



Typical Flux Density VS Output Voltage

12 功能参数描述

(1) V_{DD} 引脚

该引脚为芯片供电引脚。供电电压必须大于最小要求的工作电压 2.8V。

(2) GND 引脚

该引脚为芯片接地引脚,并且需要保证与供电电源的地是强连接。

(3) Output 引脚

HX6659 为推挽式输出结构,无需上拉电阻。当无外加磁场时,输出电压为Vpp/2。当向芯片施加S极磁场时, 输出电压会大于Vpp/2。当向芯片施加N极磁场时,输出电压会小于Vpp/2。输出电压更新都会发生在Tsw之 后。

(4) 上电时间 (Power on Time)

当向芯片施加电压时,芯片需要一定的建立时间来响应外加磁场。

(5) 零输出电压 (Null Voltage output)

当外加磁场为 0 时,输出电压为电源电压 V_{DD} 电压的一半。

(6) 灵敏度 (Sensitivity)

输出电压的变化量正比于磁场强度的变化量,这种正相关性如下式:

Sens =
$$\frac{V_{OUT(B+)} - V_{OUT(B-)}}{(B+) - (B-)}$$

(7) 线性度 (Linearity)

芯片对于线性磁场可以提供线性输出。考虑两个磁场点, B1 和 B2, 理想情况下, 对于给定的供电电压和温度, 芯片的灵敏度在两个磁场点上是相同的。对于正向磁场和负向磁场分别给出了线性度计算如下式:

$$Lin_{B+} = (1 - \frac{Sens_{(B2+)}}{Sens_{(B1+)}}) \times 100\%$$

$$Lin_{B-} = (1 - \frac{Sens_{(B2-)}}{Sens_{(B1-)}}) \times 100\%$$

$$Lin_{B_{-}} = (1 - \frac{Sens_{(B2-)}}{Sens_{(B1-)}}) \times 100\%$$

(8) 比例输出误差 (Ratiometry Error)

芯片提供比例输出模式。这意味着 0 电压输出 Vnull, 灵敏度 Sens,正比于供电电压 VDD。比例值相对于 5V 而言,如下式所示:

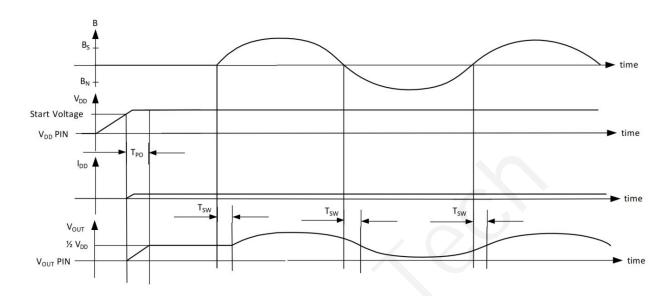
$$R_{Von} = (1 - \frac{Vnull_{V_{DD}}/Vnull_{5V}}{V_{DD}/5V}) \times 100\%$$

$$R_{Sens} = (1 - \frac{Sens_{V_{DD}}/Sens_{5V}}{V_{DD}/5V}) \times 100\%$$



时序图

Power on timing



● Power-On time (TPO):

外接电源给芯片供电开始到芯片正常工作,这之间的时间。

Output switch time, (TSW):

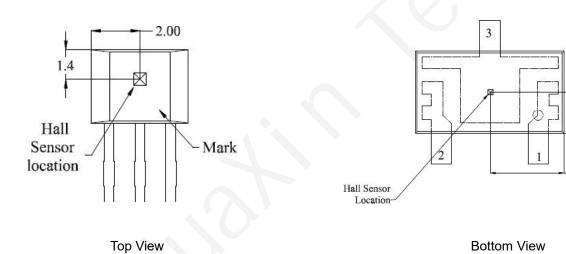
从磁场变化开始到芯片输出响应相应的变化,这之间的时间。



13 订货信息

型号	封装形式	引脚数	灵敏度	温度
HX6659ISO-A	SOT-23	3	1.5mV/Gs	-40℃~125℃
HX6659ISO-B	SOT-23	3	2.0mV/Gs	-40℃~125℃
HX6659ISO-C	SOT-23	3	2.5mV/Gs	-40℃~125℃
HX6659ISO-D	SOT-23	3	3.0mV/Gs	-40℃~125℃
HX6659IUA-A	TO-92S	3	1.5mV/Gs	-40℃~125℃
HX6659IUA-B	TO-92S	3	2.0mV/Gs	-40℃~125℃
HX6659IUA-C	TO-92S	3	2.5mV/Gs	-40℃~125℃
HX6659IUA-D	TO-92S	3	3.0mV/Gs	-40℃~125℃

14 Hall盘位置



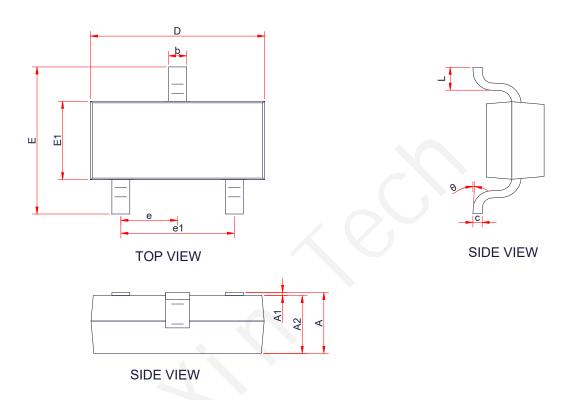
-0.80

1.45



封装外形尺寸图

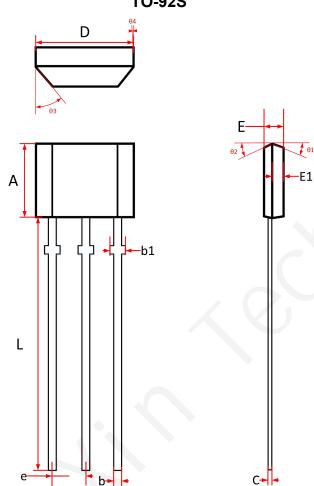
SOT-23



0	Dia	Dimensions in Millimeters				
Symbol	Min.	Тур.	Max.			
A	-	-	1.25			
A1	0.00	-	0.1			
A2	1.00	1.10	1.15			
b	0.30	-	0.50			
С	0.10	-	0.20			
D	2.82	2.95	3.02			
E	2.65	2.80	2.95			
E1	1.50	1.65	1.70			
е	0.85	0.95	1.05			
e1	1.80	1.90	2.00			
L	0.30	0.45	0.60			
θ	0 °	-	8 °			



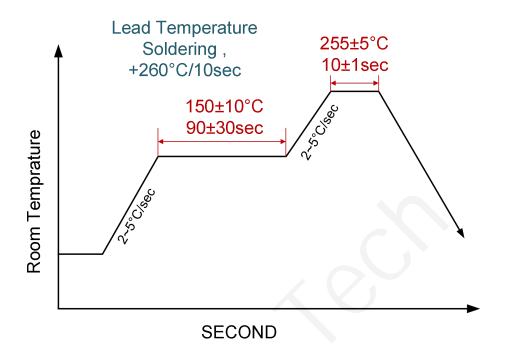
TO-92S



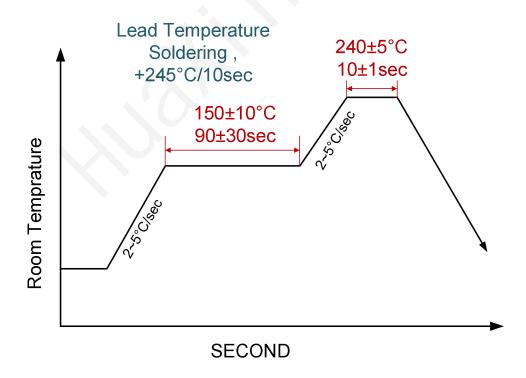
Comphal	Dimensions in Millimeters			
Symbol	Min.	Тур.	Max.	
Α	2.90	3.00	3.10	
b	0.35	0.39	0.50	
b1	0.40	0.44	0.55	
С	0.36	0.38	0.45	
D	3.90	4.00	4.10	
Е	1.42	1.52	1.62	
E1		0.75		
е	1.27 TYP			
L	13.50	14.50	15.50	
θ 1		6°		
θ 2		3°		
θ 3		45°		
θ 4		3°		



IR Reflow curve



SOT-23 Soldering Condition



TO-92S Soldering Condition

华芯温馨提示

- 1.霍尔是敏感器件,在使用过程以及存储过程中请注意采取静电防护措施。
- 2. 霍尔在安装过程中应尽量避免对霍尔本体施加机械应力,如管脚需要弯曲请在距引线 3mm 以外操作。
- 3.建议焊接温度:电烙铁焊接,建议温度 350℃,最长 5 秒。 波峰焊:建议最高温度 260℃,最长 3 秒。 红外回流焊:建议最高 245℃,最长 10 秒。
- 4.不建议超越数据表中的参数使用,虽然极限参数下霍尔会正常工作,但是长时间处于极限 条件下可能会造成霍尔或者实际产品的损坏,为了保障霍尔的正常工作和产品的安全性稳 定性,请在数据表许可范围内使用。

获取更多信息,定制化系统等,欢迎联系我们